PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-204388

(43) Date of publication of application: 09.08.1996

(51)Int.CI.

H05K 13/02 B65G 47/14 B65G 65/40

(21)Application number: 07-027428

(71) Applicant: MURATA MFG CO LTD

(22) Date of filing:

23.01.1995

(72)Inventor: HAMURO MITSUO

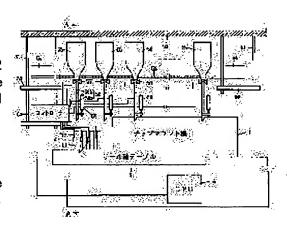
SHIMAMAKI KEIICHI

(54) CHIP PARTS AUTOMATICALLY SUPPLEMENTING APPARATUS

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide an automatic supplementing apparatus capable of automatically supplementing chip parts in a store space when the stock of the parts in this space of an arranging and feeding mechanism is below a fixed level.

CONSTITUTION: An arranging and feeding mechanism 2 has a space 12 to store plural chip parts and outlet hole to arrange them housed in the space 12 one by one and discharge them. When a detecting sensor detects that the amount of the chip parts in the space 12 is below a reference level, the parts are supplemented via a supplement route 56 into the space 12 from a chip tank 55 disposed at an upper part of the mechanism 2. In the midway of this route a valve 57 is provided which opens the route 56 in response to the sensor and closes it when specified number of the chip parts are supplemented into the space 12.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 14.05.1998 [Date of sending the examiner's decision of

rejection

05.10.1999

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3079934

23.06.2000 [Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

11-17497

of rejection]

02.11.1999

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報 (B2)

(11)特許番号

特許第3079934号

(P3079934)

(45)発行日 平成12年8月21日(2000.8.21)

(24)登録日 平成12年6月23日(2000.6.23)

(51) Int. C1. 7

識別記号

H O 5 K 13/02

FI

H 0 5 K 13/02

D

請求項の数4

(全8頁)

(21)出願番号 特願平7-27428

(22)出願日 平成7年1月23日(1995. 1. 23)

(65)公開番号 特開平8-204388

(43)公開日 平成8年8月9日 (1996. 8. 9) 審査請求日 平成10年5月14日 (1998. 5. 14)

前置審查

(73)特許権者 000006231

株式会社村田製作所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

(72)発明者 羽室 光郎

京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(72)発明者 嶋巻 敬一

京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(74)代理人 100085497

弁理士 筒井 秀隆

審査官 黒石 孝志

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】チップ部品の自動補給装置

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】複数のチップ部品を収納する収納空間と、収納空間に収納されたチップ部品を1個ずつ整列させて 排出する排出口とを<u>有し、チップ部品の種類に応じて複</u> 数設けられた整列供給機構と、

<u>上記整列供給機構を一列に配列して支持し、整列供給機構を配列方向に移動させる可動テーブルと、</u>

所定位置に移動された整列供給機構の排出口から排出されたチップ部品をチャックしてプリント基板に搭載する チップマウント機と、

上記収納空間内のチップ部品が基準数以下になったこと を検出する検出センサと、

上記整列供給機構より上部に配置され、上記収納空間に 収納できるチップ部品数より多数のチップ部品を収容で き、整列供給機構に対応して複数設けられたチップタン 2

クと、

上記チップタンクから上記収納空間内にチップ部品を補給する補給通路と、

上記検出センサより信号が入力され、基準数以下になった整列供給機構に対応するチップタンクから補給通路を介して所定数のチップ部品を整列供給機構へ補給するよう制御する制御手段とを備え、

上記制御手段はチップマウンタ機の基板ローディング期間を利用して整列供給機構へのチップ部品の補給動作を行うよう制御することを特徴とするチップ部品の自動補給装置。

【請求項2】請求項1に記載の自動補給装置において、 上記チップタンクを移動させる移動手段が設けられ、 チップマウンタ機が動作中にいずれかの整列供給機構の 収納空間のチップ部品が基準数以下になった時、そのチ 3

ップ部品を収容したチップタンクを予め整列供給機構の <u>補給位置</u>の上方へ移動させ、チップマウンタ機の基板ロ ーディングを開始すると同時に整列供給機構を<u>補給位置</u> へ移動させ、チップタンクから整列供給機構への補給を 開始することを特徴とするチップ部品の自動補給装置。

【請求項3】請求項1または2に記載の自動補給装置に おいて.

上記<u>所定の</u>チップタンクと整列供給機構とが上下に対応 するよう、少なくとも<u>一方を</u>移動させる移動手段が設け られ、

上記収納空間の後端部に部品補給用の開口部が形成され、

上記補給通路は、上下方向に伸縮自在でかつ内部を上記 チップ部品が通過し得るパイプで構成され、

上記パイプの下端部を上下方向に移動させ、この下端部 を上記開口部に挿入させる挿入手段が設けられているこ とを特徴とするチップ部品の自動補給装置。

【請求項4】請求項1または2に記載の自動補給装置に おいて、

上記収納空間の後端部に部品補給用の開口部が形成され.

上記補給通路は、内部を上記チップ部品が通過し得るフレキシブルチューブで構成され、

上記チューブの下端部を把持して上記収納空間の上方へ 移動させ、かつ上記収納空間に挿入させる移動・挿入手 段が設けられていることを特徴とするチップ部品の自動 補給装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はチップ部品を1個ずつ整 30 列させて供給する整列供給機構において、この整列供給 機構にチップ部品を自動的に補給する装置に関するもの である。

[0002]

【従来の技術】従来、チップ部品を自動的にプリント基板に搭載するため、チップマウント機が用いられている。この装置の場合、バラ状態で供給されたチップ部品を一列に整列させ、かつ1個ずつ供給するため、バルクフィーダと呼ばれる整列供給機構が不可欠である。このような目的で、カートリッジ式チップケースを備えたチ 40ップ部品の自動整列供給装置が知られている(例えば特開昭63-127600号公報参照)。このチップケースは、製造業者がチップ部品を出荷する際の包装容器として使用されるだけでなく、チップ部品の組立業者においては、これをそのままチップマウント機に装着して用いることができる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】チップケースには、チップ部品の大きさにもよるが、例えば5千個~10万個程度のチップ部品が収納される。しかしながら、チップ 50

マウント機の高速化により、この程度のチップ部品を収容できるチップケースであっても、比較的短時間でチップ部品を消費してしまう傾向にある。そのため、作業者はチップケースの消費量を監視し、空になったチップケースを整列供給装置本体から取外し、新しいチップケースと交換する必要がある。チップマウント機の場合、基板ローディング時に4~6秒程度の間停止するが、このような短時間ではチップケースを交換するのは不可能であるため、交換のためにチップマウント機をある程度の10時間停止させなければならず、作業効率が低下する原因

となっていた。また、作業者は交換作業のためにチップ マウント機の近くに待機していなればならず、自動化.

無人化が困難であった。
【0004】チップケースを大型化すれば交換回数を減らすことができるが、一般に整列供給装置は、チップマウント機の一部として設置され、かつ複数種類のチップ部品を同時に供給できるように、厚さ方向に複数個並列に配置されるため、スペース上の制約がある。しかも、整列供給装置はチップマウント機の動きに対応して高速で往復移動する必要性があるため、重量増加をできるだ

【0005】そこで、本発明の目的は、整列供給機構の 収納空間のチップ部品が一定量以下になった時、収納空 間に自動的にチップ部品を補給できる自動補給装置を提 供することにある。

け避けなればならない。そのため、チップケースは薄型

となり、大型化することができなかった。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の自動補給装置は、複数のチップ部品を収納 する収納空間と、収納空間に収納されたチップ部品を1 個ずつ整列させて排出する排出口とを<u>有し、チップ部品</u> <u>の種類に応じて複数設けられた</u>整列供給機構と、上記整 列供給機構を一列に配列して支持し、整列供給機構を配 列方向に移動させる可動テーブルと、所定位置に移動さ れた整列供給機構の排出口から排出されたチップ部品を <u>チャックしてプリント基板に搭載するチップマウント機</u> <u>と、</u>上記収納空間内のチップ部品が基準数以下になった ことを検出する検出センサと、上記整列供給機構より上 部に配置され、上記収納空間に収納できるチップ部品数 より多数のチップ部品を収容でき、整列供給機構に対応 して複数設けられたチップタンクと、上記チップタンク から上記収納空間内にチップ部品を補給する補給通路 と、上記検出センサより信号が入力され、基準数以下に なった整列供給機構に対応するチップタンクから補給通 路を介して所定数のチップ部品を整列供給機構へ補給す るよう制御する制御手段とを備え、上記制御手段はチッ プマウンタ機の基板ローディング期間を利用して整列供 <u>給機構へのチップ部品の補給動作を行うよう制御するこ</u> とを特徴とするチップ部品の自動補給装置を提供する。

【0007】チップタンクは、例えば1カ月分の使用量

(100万個以上)が入る程度の容量を持つものが望ま しい。整列供給機構が種類の異なるチップ部品を供給す るため複数個並列に配置されている場合には、チップタ ンクも整列供給機構に対応して複数個配置するのが望ま しい。

【0008】好ましい実施例によれば、収納空間の後端 部に部品補給用の開口部を形成し、補給通路を、上下方 向に伸縮自在でかつ内部をチップ部品が通過し得るパイ プで構成する。この場合、チップタンクと整列補給機構 とが上下に対応するよう、少なくともいずれか一方を水 10 平方向へ移動させる移動手段と、パイプの下端部を上下 方向に移動させ、そのパイプの下端部を開口部に挿入さ せる挿入手段とを設けるのが望ましい。また、他の好ま しい実施例によれば、補給通路を内部をチップ部品が通 過し得るフレキシブルチューブで構成してもよい。この 場合には、チューブの下端部を把持して収納空間の上方 へ移動させ、かつ収納空間に挿入させる移動・挿入手段 を設けるのが望ましい。

[0009]

品を1個ずつ整列させ、排出口より排出する。排出され <u>たチップ部品をチップマウント機がチャックしてプリン</u> ト基板にマウントする。 収納空間内のチップ部品が基準 数以下まで減少すると、検出センサが検知し、制御手段 がチップタンクから整列供給機構の収納空間に補給通路 <u>を接続する。</u>これにより、チップタンク内に収容された チップ部品は重力の作用により、補給通路を通って収納 空間へ補給される。収納空間内のチップ部品が一定量以 上になると、補給通路が閉じられ、チップ部品の補給が 止まる。そのため、収納空間内のチップ部品が溢れ出る 恐れがない。

【0010】<u>チップ</u>部品の補給動作をチップマウント機 の動作中に行うことができれば、マウント機の無停止補 給が可能となり、作業効率が向上する。しかし、ワンバ イワン型のチップマウント機の場合、整列供給装置が高 速で往復移動するため、自動補給装置をこれに追随させ ることは難しい場合がある。そこで、<u>本発明では</u>チップ マウント機の基板ローディング時(例えば4~6秒間) を利用して補給を行う。本発明では、チップケースを交 換するのではなく、収納空間に補給通路を介してチップ 40 部品を補給するため、上記のような短期間でも補給が可 能である。

[0011]

【実施例】図1, 図2は本発明をチップマウント機に適 用した一例を示す。1はワンバイワン方式のチップマウ ント機、2は整列供給装置であるバルクフィーダ、3は チップマウント機1に対し水平方向に移動するリール軸 テーブルである。バルクフィーダ2はリール軸テーブル 3の上面に厚み方向に並列に複数個設置されている。図 1では4個のバルクフィーダ2が設置されているが、チ 50

ップマウント機1で用いられるチップ部品の種類に応じ て任意に設定できる。

【0012】まず、バルクフィーダ2について説明す る。このバルクフィーダ2は、後述するチップケース1 2とチップ有無検出用センサ45とセンサ感度調整部4 6とを除いて既に公知のものである。バルクフィーダ2 は、図3に示すように、本体10と、本体10に対して 着脱可能なバルクカセット11と、バルクカセット11 に対して着脱自在なチップケース12とで構成されてい る。バルクフィーダ本体10には、バルクカセット10 を約45°傾けた状態で支持する三角ベース13、上下 方向に駆動されるフィードレバー14、フィードレバー 14を上方へ付勢する戻しバネ15、圧縮エアの開閉用 メカバルブ16、インデックスピン突き上げ用レバー1 7、インデックステーブル18、インデックスホイール 19、ラック・ピニオン機構20等が設けられている。 【0013】フィードレバー14を押し下げると、メカ バルブ16が開かれ、圧縮エアがバルクカセット11内 に送り込まれる。また、フィードレバー14の押し下げ 【作用】整列供給機構は収納空間に収納されたチップ部 20 により、ラック・ピニオン機構20を介してインデック スホイール19が一定角度(例えば90°)回転する。 インデックスホイール19の外周部には、チップ部品が 1個ずつ嵌合する溝が例えば90°間隔で形成されてお り、バルクカセット11の排出口から排出された1個の チップ部品はインデックスホイール19の溝に嵌まった 状態で所定角度回転させられ、インデックステーブル1 8上の所定位置で停止する。また、フィードレバー14 の押し下げ動作に連動して、インデックスピン突き上げ レバー17も押し下げされる。この突き上げレバー17 の押し下げにより、図示しない連動機構を介してインデ ックステーブル18上の所定位置で停止しているチップ 部品をピン(図示せず)で突き上げる動作を行う。この 状態で、チップ部品はチップマウント機1によりチャッ クされ、取り出される。バルクフィーダ本体10の後部 には、本体10をリール軸テーブル3に固定するための クランプ爪21と、クランプ爪21を作動させるクラン プレバー22とが設けられている。

> 【0014】バルクカセット11は、図4に示すよう に、後端部に導入口30を有し、上記導入口30にチッ プケース12が着脱交換可能となっている。この実施例 では、図5のようにバルクカセット11側に凹溝32が 形成され、チップケース12側には突条40が形成され ている。チップケース12の突条40をバルクカセット 11の凹溝32にスライドさせることにより、チップケ ース12はバルクカセット11に取り付けられ、かつバ ルクカセット11の導入口30とチップケース12の開 口部41とが対応する。

> 【0015】バルクカセット11内に導入されたチップ 部品は、まず大部屋33に流れ込み、次いで小部屋34 に流れ込み、最終的に整列通路35に入る。整列通路3

5の入口近傍には2方向の圧縮エア噴出口36が形成さ れ、これら噴出口36は上記メカバルブ16と接続され ている。メカバルブ16が開かれると、噴出口36から 圧縮エアが噴出され、小部屋34内のチップ部品が吹き ほぐされて整列通路35に1個ずつ入り込むとともに、 整列通路35内のチップ部品が前方へ押し出される。整 列通路35の前端には排出口37が設けられており、こ の排出口37からチップ部品が1個ずつ整列されて排出 される。なお、バルクカセット11の内部構造は、特開 平3-187298号公報に記載のものと同様であるた 10 持テーブル53の下面に固定された縦壁59 (図2参 め、ここでは詳しい説明を省略する。

【0016】チップケース12は透明な樹脂ケースより なり、前端部と後端部とにそれぞれ開口部41,42が 形成されている。前端部に形成された開口部41は、ス ライド自在な帯板43で開閉される。帯板43は可撓性 を有する薄板よりなり、この帯板43の後端部には手動 操作用の撮み44が取り付けられている。チップケース 12をバルクカセット11に取り付けた状態で、帯板4 3を開き方向にスライドさせることにより、チップケー ス12内のチップ部品がバルクカセット11内に供給さ 20 れる。チップケース12の開口部41近傍には、チップ 有無検出用センサ45 (図3参照) が取り付けられてい る。このセンサ45は、チップケース12内のチップ部 品が一定量以下になったことを検出するものであり、反 射型光センサが望ましいが、透過型光センサやその他の センサ (接触型センサ、機械的スイッチ等) であっても よい。センサ45はバルクフィーダ本体10の後端部に 取り付けられたセンサ感度調整部46を介して、コント ローラ60と接続されている。

【0017】チップケース12の後端側の開口部42に 30 は、内側へ開くことができる開閉式の蓋板47が取り付 けられている。蓋板47は、図6のように軸48を中心 として上下方向に回動自在であり、コイルばね49によ って閉鎖方向に付勢されている。上記開口部42には、 後述する補給用パイプ56の下端部が挿入される。この 時、蓋板47がパイプ56に押されて容易に開くため、 パイプ56からチップ部品がチップケース12内に円滑 に補給される。

【0018】次に、自動補給装置について説明する。リ ール軸テーブル3の上方には、図1のように天井50が 40 設けられており、天井50には複数本の支柱51が吊り 下げられ、その支柱51を介して複数の棚板52が固定 されている。棚板52上には、支持テーブル53を水平 方向に駆動させる一軸駆動機構54が設けられている。 この駆動機構54はコントローラ60によって制御され る。上記支持テーブル53には、複数本のチップタンク 55が倒立状態で支持されており、各チップタンク55 にはそれぞれ種類の異なるチップ部品が例えば100万 個単位で収納されている。図1では4個のチップタンク 55が図示されているが、その個数は任意である。チッ 50

プタンク55の下端開口には、互いに摺動自在な補給用 パイプ56が着脱可能に接続されており、このパイプ5 6とチップタンク55との接続部には開閉弁57が設け られている。この開閉弁57もコントローラ60によっ て制御される。

【0019】補給用パイプ56は、互いに摺動自在な2 本のパイプ56 a, 56 b で構成されており、下方のパ イプ56aは挿入手段である挿入用エアシリンダ5.8に よって上下に駆動される。なお、エアシリンダ58は支 照) に取り付けられており、コントローラ60によって 制御される。エアシリンダ58を駆動させると、パイプ 56aが下方へ突出し、その下端部が上述のチップケー ス12に挿入される。パイプ56aの下端部は、鋭角的 に尖っており、チップケース12へ挿入しやすくしてあ る。パイプ56は、円パイプに限らず、角パイプであっ てもよいことは勿論であり、内部をチップ部品が円滑に 落下できる断面積を有するものであればよい。

【0020】コントローラ60はチップマウント機1と 連動して、自動補給装置を構成する上記駆動機構54、 開閉弁57、エアシリンダ58を制御する。また、コン トローラ60は、チップマウント機1の動きと連係する ように、チップマウント機1の中央制御装置(CPU) 4とも接続されている。CPU4はチップマウント機1 を制御するだけでなく、チップマウント機1の動きに同 期してリール軸テーブル3を駆動させ、かつバルクフィ ーダ2のフィードレバー14およびインデックス突き上 げレバー17を操作するよう指令する。

【0021】次に、上記構成の自動補給装置の動作を図 7に従って説明する。1枚のプリント基板がチップマウ ント機1へ取り入れられる(ローデングされる)と、チ ップマウント機1は、このプリント基板にバルクフィー ダ2から供給されたチップ部品を1個ずつマウントす る。1枚のプリント基板へのマウント作業が終了する と、そのプリント基板が次工程へ取り出されるととも に、新たなプリント基板が取り入れられる。この基板ロ ーディング時にはチップマウント機は一時的に停止する ことになる。この停止時間は、通常、4~6秒程度であ

【0022】一方、マウント動作中に、チップケース1 2内のチップ部品が一定量以下になると、チップ有無検 出用センサ45がこれを検出し(ステップS1)、コン トローラ60に信号を送る。これにより、コントローラ 60は次回の基板ローディング時に補給動作を行うべ く、準備作業に入る。つまり、空になったチップケース 12の品番を確認し(ステップS2)、これと同品番の チップタンク55が、補給位置のバルクフィーダ2上へ 対応するように、予め支持テーブル53を移動させてお く(ステップS3)。

【0023】基板ローディングを開始すると(ステップ

S4)、CPU4はリール軸テーブル3を補給位置へ移 動させる(ステップSェ)。これにより、空になったチ ップケース12を持つバルクフィーダ2が、これと同品 番のチップタンク55の下へ対応することになる。図1 は左端のバルクフィーダ2と左端のチップタンク55と が上下に対応した状態を示す。次に、コントローラ60 はエアシリンダ58を下降させ(ステップS₆)、補給 用パイプ56aの下端部をチップケース12の開口部4 2に挿入する。挿入とほぼ同時に、コントローラ60は 開閉弁57を開く(ステップSァ)。これにより、チッ プタンク55内のチップ部品は自重落下によりパイプ5 6を通ってチップケース12に補給される。開閉弁57 を開いて所定時間経過すると、コントローラ60は開閉 弁57を閉じる(ステップSs)。開閉弁57を開いて いる時間は、パイプ56を通って落下したチップ部品が チップケース12内にほぼ充填され、チップケース12 から溢れることがない程度の時間である。チップケース 12への補給が終了すると、コントローラ60はエアシ リンダ58を上昇させ(ステップS₉)、パイプ56a 上昇させた後、CPU4はリール軸テーブル3を原点へ 復帰させる (ステップ S10)。上記の補給動作と並行し て、基板ローディングが行われるので、補給動作が終了 するとほぼ同時に基板ローディングも終了する。基板ロ ーディング後、チップマウント機1は通常どおりマウン ト動作を再開する。上記のように、基板ローディング時 間を利用してチップ部品の補給動作を行うので、チップ マウント機1を補給のために個別に停止させる必要がな く、チップマウント機1を実質的に無停止で連続運転で きる。

【0024】上記実施例では、チップタンク55を支持した支持テーブル53を水平方向へ移動させ、チップタンク55を空になったバルクフィーダ2の上へ移動させるようにしたが、これに限るものではなく、チップタンク55を支持した支持テーブル53を固定しておき、バルクフィーダ2を支持したリール軸テーブル3を所望の位置へ移動させてもよい。

【0025】図8,図9は本発明の自動補給装置の第2 実施例を示す。図において、図1,図2と同一部品には同一符号を付して説明を省略する。複数のチップタンク55は天井50から吊り下げ固定された棚70上に支持されている。したがって、チップタンク55は一定位置に支持されている。チップタンク55の下端開口には、フレキシブルチューブ71が着脱可能に接続されており、このチューブ71とチップタンク55との接続部には開閉弁57が設けられている。この開閉弁57もコントローラ60によって制御される。なお、チューブ71の垂下位置は、バルクフィーダ2の動作中、バルクフィーダ2と干渉しない位置にある。

【0026】上記棚70の下方には水平な棚72が固定 50 たが、バルクカセットの収納空間がある程度の容量を有

10

されており、この棚72にX-Yロボット73が搭載されている。ロボット73はコントローラ60によって制御され、棚72に沿ってX-Y方向(水平方向)に移動可能である。このロボット73は上記チューブ71の下端部を把持するチャックハンド74と、チャックハンド74を上下に移動させるシリンダ75とを備えている。ロボット73は、一定位置で下方へ垂下しているチューブ71の下端部をチャックハンド74で把持した後、シリンダ75によって上方へ持ち上げ、水平方向へ移動して所望のバルクフィーダ2上へ移動する。そして、再びシリンダ75を駆動してチューブ71の下端部を空のチップケース12の開口部42に挿入する。

を開いて所定時間経過すると、コントローラ60は開閉 457 を閉じる(ステップSs)。開閉弁57を開いて た後、第1実施例と同様に、コントローラ60は開閉弁 いる時間は、パイプ56を通って落下したチップ部品が 57 を開き、一定量のチップ部品をチップタンク55か 57 を開き、一定量のチップ部品をチップタンク55か 57 を開き、一定量のチップ部品をチップタンク55か 57 を開き、一定量のチップ部品をチップタンク55か 57 を開き、一定量のチップ部品をチップタンク55か 57 を開き、一定量のチップ部品をチップタンク55か 57 を開き、そして、再びシリンダ75に 57 ない程度の時間である。チップケース 57 ない程度の時間である。チップケース 57 ない程度の時間である。チップケース 57 ない程度の時間である。チップケース 57 ない程度の時間である。チップケース 57 ないるは 57 ないる 57

【0028】上記実施例の場合、チップタンク55が一定位置に支持されているので、バルクフィーダ2とチップタンク55との位置が離れていると、フレキシブルチューブ71を大きく屈曲させる必要があり、またチューブ71の長さを、バルクフィーダ2とチップタンク55とが最大限離れた位置でもチップ部品を補給できる長さにする必要がある。そこで、リール軸テーブル3を駆動し、空のチップケースを持つバルクフィーダ2をチップ30タンク55の近くへ移動させるようにすれば、チューブ71を大きく屈曲させる必要はなく、かつチューブ71の長さも短くてすむ。

【0029】本発明は上記実施例に限定されるものではない。上記第1,第2実施例では、補給動作を基板ローディング中に行うようにしたが、マウント動作中のバルクフィーダ2に対して、チップタンク55またはチューブ71を同期して動作させ、空になったチップケース12にその都度チップ部品を補給するようにしてもよい。この場合には、チップマウント機1の無停止補給が可能となり、一層の作業効率向上を達成できる。

【0030】また、本発明の自動補給装置は、2組のバルクフィーダを設け、そのうちの1組がマウント動作中の間、他の1組を待機させるようにしたチップマウント機に適用することもできる。この場合には、この待機中のバルクフィーダに自動補給装置でチップ部品を補給すればよいので、時間的な余裕があり、自動補給装置を高速で動作させる必要がない。

【0031】さらに、上記実施例では、チップケースを 介してチップ部品をバルクカセットに補給するようにし たが、バルクカセットの収納空間がある程度の容量を有 する場合には、バルクカセットに対して直接チップ部品 を補給することが可能である。したがって、この場合に はチップケースを省略することも可能である。なお、本 発明は、整列供給装置を備えた機械であれば、チップマ ウント機に限らず他の機械(例えば自動テーピング機) にも適用できる。

[0032]

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明に よれば、整列供給機構の収納空間内のチップ部品が基準 数以下まで減少すると、検出センサが検知し、チップタ 10 ンクから補給通路を介して所定量のチップ部品を収納空 間へ補給するようにしたので、チップ部品の補給作業の 自動化、無人化が可能となる。特に、補給通路を介して チップ部品を補給するため、従来のようにチップケース を着脱する必要がなく、補給に時間を必要としない。 主 た、チップマウント機の<u>基板ローディング期間を利用し</u> て整列供給機構へのチップ部品の補給を行うようにした <u>ので、</u>チップマウント機の実質的な無停止運転が可能と なり、稼働率を格段に向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかる自動補給装置の第1実施例の全 体図である。

【図2】図1の自動補給装置のA-A線断面図である。

【図3】バルクフィーダの斜視図である。

【図4】バルクカセットおよびチップケースの断面図で ある。

12

【図5】図4のB方向矢視図である。

【図6】蓋板の斜視図である。

【図7】 本発明の自動補給装置の動作の一例のフローチ ャート図である。

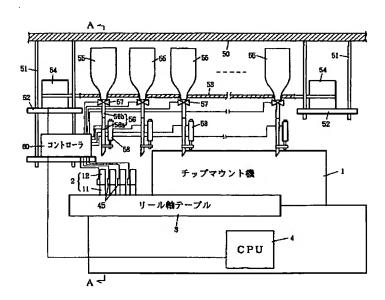
【図8】本発明にかかる自動補給装置の第2実施例の全 体図である。

【図9】図8の自動補給装置の右側面図である。

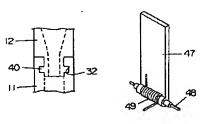
【符号の説明】 チップマウント機 1

-	, , , , , , , , , , , ,
2	バルクフィーダ

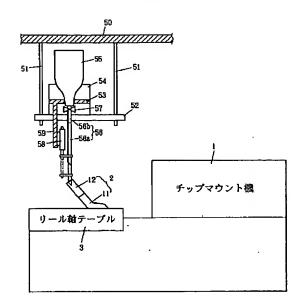
【図1】



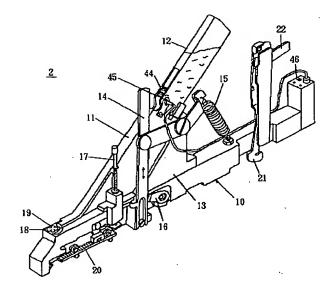
【図5】 【図6】



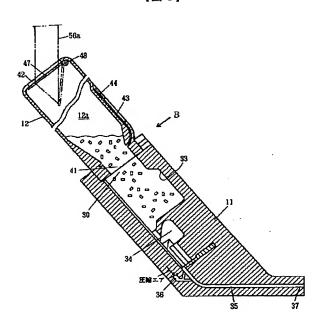
[図2]



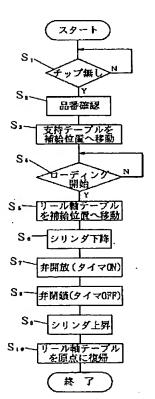
【図3】



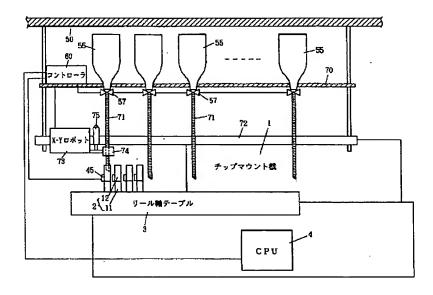
【図4】



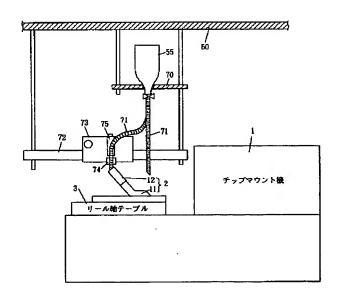
【図7】



【図8】



【図9】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開 平7-15169 (JP, A)

特開 平3-200594 (JP, A)

特開 平5-49953 (JP, A)

特開 平6-188591 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl.⁷, DB名) H05K 13/00 - 13/04